

东芯半导体股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近期股价波动较大，存在市场情绪过热及非理性炒作的风险。公司股票价格自2026年6月26日至2026年6月30日连续3个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到6.66%，2026年6月16日至2026年6月30日连续10个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到24.74%，股票价格短期累计涨幅较大，未来可能存在股价快速回落风险。
- 根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2026年6月30日的市盈率数据显示，公司所属的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最新静态市盈率为81.94，公司静态市盈率为负数，显著高于行业水平，存在估值较高的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
- 公司所处的存储行业具有明显的周期性特征，公司的经营业绩与行业周期波动密切相关。未来如果存储行业再次进入下行周期，市场需求的减弱和产品价格的下跌将对公司的销售收入、毛利率及盈利水平等产生直接不利影响，进而可能导致公司未来经营业绩出现较大幅度的波动。
- 公司采用Fabless经营模式，专注于芯片的研发设计与销售，产品生产依赖上游代工厂稳定的产能支持。公司采取“本土深度、全球广度”的供应链策略，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系，并根据市场供需关系动态调整投片规模。然而，在当前利基存储市场整体供应短缺的背景下，如果未来上游代工厂产能供给进一步紧张，导致公司无法获得充足的

产能支持，或者代工价格持续上涨，将对公司的产品交付、成本控制及整体经营业绩产生不利影响。

- 为维持公司的竞争地位并继续发展业务，公司持续围绕“存、算、联”一体化战略推进技术研发与产品迭代。然而，集成电路设计行业技术门槛高、研发投入大、产品研发周期长，芯片产品需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践。研发过程较为复杂，存在不确定性，研发项目可能存在研发失败或产业化失败的风险，可能导致公司竞争力有所下降，从而影响公司后续发展。
- 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、股价短期上涨后快速回落的风险

公司股票价格自2026年6月26日至2026年6月30日连续3个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到6.66%，2026年6月16日至2026年6月30日连续10个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到24.74%，股票价格短期累计涨幅较大，未来可能存在股价快速回落风险。

二、估值较高的风险

根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2026年6月30日的市盈率数据显示，公司所属的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最新静态市盈率为81.94，公司静态市盈率为负数，显著高于行业水平，存在估值较高的风险。

三、存储行业周期波动风险

公司所处的存储行业具有明显的周期性特征。目前，存储行业正处于周期性上行时期，市场需求较为旺盛，供给端的扩张相对有限，产品价格处于高位。然而，公司过往也曾经历过周期性低迷时期，在行业低谷期通常面临终端需求不足、产品价格低迷、市场竞争加剧以及库存水平高企等不利局面。

公司的经营业绩与行业周期波动密切相关。因此，未来如果存储行业再次进入下行周期，市场需求的减弱和产品价格的下跌将对公司的销售收入、毛利率及

盈利水平等产生直接不利影响，进而可能导致公司未来经营业绩出现较大幅度的波动。

四、公司经营风险

公司深耕利基型存储市场多年，是国内少数可同时提供NAND、NOR、DRAM完整存储解决方案的厂商。公司下游客户主要集中在网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与汽车电子等领域。

目前利基型存储市场正面临供需关系的结构性失衡。供给端方面，全球存储产业的供给侧正面临结构性调整，海外头部厂商陆续战略性退出2D NAND市场，将产能资源向HBM等高附加值的高端存储产品倾斜，导致通用型及利基型存储的有效供给持续收缩。而在需求端方面，与主流通用存储相比，利基型存储下游需求基本面更为稳定：工控、车用电子、通信等核心应用领域需求保持稳步增长，且SLC NAND 在高可靠性、高耐久性等关键性能指标上具备不可替代性，下游客户需求具有持续性与刚性特征。

公司采用Fabless经营模式，专注于芯片的研发设计与销售，产品生产依赖上游代工厂稳定的产能支持。公司采取“本土深度、全球广度”的供应链策略，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系，并根据市场供需关系动态调整投片规模。然而，在当前利基存储市场整体供应短缺的背景下，如果未来上游代工厂产能供给进一步紧张，导致公司无法获得充足的产能支持，或者代工价格持续上涨，将对公司的产品交付、成本控制及整体经营业绩产生不利影响。

五、公司研发风险

为维持公司的竞争地位并继续发展业务，公司持续围绕“存、算、联”一体化战略推进技术研发与产品迭代。然而，集成电路设计行业技术门槛高、研发投入大、产品研发周期长，芯片产品需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践。研发过程较为复杂，存在不确定性，研发项目可能存在研发失败或产业化失败的风险，可能导致公司竞争力有所下降，从而影响公司后续发展。

六、其他说明

截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在其他应披露未披露的重大事项。公司提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年7月1日